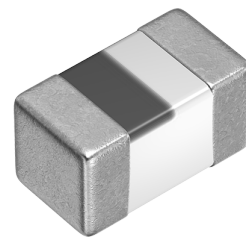


用途  一般等级特点 **Multilayer** 积层
Non-Mag Core 非磁性核心(电介质陶瓷)

系列 | 型 MLG

状态  量产体制

品牌 TDK



尺寸

长度(L)	0.60mm ±0.03mm
宽度(W)	0.30mm ±0.03mm
厚度 高低	0.30mm ±0.03mm
推荐焊盘布局(A)	0.25mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.30mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.30mm Nom.

电气特性

电感	56nH ±3% at 100MHz
额定电流	50mA
直流电阻 [Typ.]	2.11 Ω
直流电阻 [Max.]	3.2 Ω
自我共振频率 [Min.]	1.2GHz
自我共振频率 [Typ.]	1.4GHz
Q [Min.]	5 at 100MHz
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~125° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	15000pcs
重量	0.0002g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

MLG0603S56NHT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

Associated Images

